



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 6346.2501—2018/IEC 60384-25-1:2006

---

## 电子设备用固定电容器 第 25-1 部分： 空白详细规范 表面安装导电高分子 固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ

Fixed capacitors for use in electronic equipment—Part 25-1: Blank  
detail specification—Surface mount fixed aluminum electrolytic  
capacitors with conductive polymer solid electrolyte—Assessment level EZ

(IEC 60384-25-1:2006, IDT)

2018-03-15 发布

2018-07-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 目 次

前言 .....	I
1 一般数据 .....	2
1.1 推荐的安装方法(应填入) .....	2
1.2 尺寸 .....	2
1.3 额定值和特性 .....	2
1.4 规范性引用文件 .....	3
1.5 标志 .....	3
1.6 订货资料 .....	3
1.7 放行批证明记录 .....	3
1.8 附加内容(不做检验用) .....	4
1.9 对总规范和(或)分规范所规定的严酷等级或要求的补充或提高 .....	4
2 检验要求 .....	4
2.1 程序 .....	4
表 1 外壳号和尺寸 .....	2
表 2 与外壳号有关的电容量值和电压值 .....	2
表 3 额定纹波电流、等效串联电阻、损耗角正切和漏电流值 .....	3
表 4 耐焊接热、稳态湿热和高温特性值 .....	3
表 5 其他特性 .....	4
表 6 质量一致性检验一览表 .....	4

## 前 言

《电子设备用固定电容器》已经或计划发布的国家标准如下：

- 第 1 部分：总规范(GB/T 2693—2001/IEC 60384-1:1999)；
- 第 2 部分：分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 7332—2011/IEC 60384-2:2005)；
- 第 2-1 部分：空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 7333—2012/IEC 60384-2-1:2005)；
- 第 3 部分：分规范 表面安装(MnO<sub>2</sub>)固体电解质钽固定电容器(GB/T 6346.3—2015/IEC 60384-3:2006)；
- 第 3-1 部分：空白详细规范 表面安装(MnO<sub>2</sub>)固体电解质钽固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.301—2015/IEC 60384-3-1:2006)；
- 第 4 部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器(GB/T 5993—2003/IEC 60384-4:1998,第 1 号修改单:2000)；
- 第 4-1 部分：空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平 E(GB/T 5994—2003/IEC 60384-4-1:2000)；
- 第 4-2 部分：空白详细规范 固体电解质(MnO<sub>2</sub>)铝电容器 评定水平 E(IEC 60384-4-2:2007)；
- 第 6 部分：分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(可供认证用)(GB/T 14004—1992/IEC 60384-6:1987)；
- 第 6-1 部分：空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 14005—1992/IEC 60384-6-1:2005)；
- 第 7 部分：分规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10185—2012)；
- 第 7-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(GB/T 10186—2012)；
- 第 8 部分：分规范 1 类瓷介固定电容器(GB/T 5966—2011/IEC 60384-8:2005)；
- 第 8-1 部分：空白详细规范 1 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5967—2011/IEC 60384-8-1:2005)；
- 第 9 部分：分规范 2 类瓷介固定电容器(GB/T 5968—2011/IEC 60384-9:2005)；
- 第 9-1 部分：空白详细规范 2 类瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 5969—2011/IEC 60384-9-1:2005)；
- 第 11 部分：分规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器(GB/T 6346.11—2015/IEC 60384-11:2008)；
- 第 11-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯膜介质直流固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.1101—2015/IEC 60384-11-1:2008)；
- 第 13 部分：分规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10188—2013/IEC 60384-13:2006)；
- 第 13-1 部分：空白详细规范 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10189—2013/IEC 60384-13-1:2006)；
- 第 14 部分：分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器(GB/T 6346.14—2015/IEC 60384-14:

- 2005);
- 第 14-1 部分:空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平 D(GB/T 6346.1401—2015/IEC 60384-14-1:2005);
  - 第 15 部分:分规范 非固体或固体电解质钽电容器(GB/T 7213—2003/IEC 60384-15:1982,第 1 号修改单:1987,第 2 号修改单:1992);
  - 第 15-1 部分:空白详细规范 非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 12794—1991/IEC 60384-15-1:1984);
  - 第 15-2 部分:空白详细规范 非固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 12795—1991/IEC 60384-15-2:1984);
  - 第 15-3 部分:空白详细规范 固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E(可供认证用)(GB/T 7214—2003/IEC 60384-15-2:1992);
  - 第 16 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器(GB/T 10190—2012/IEC 60384-16:2005);
  - 第 16-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 10191—2011/IEC 60384-16-1:2005);
  - 第 17 部分:分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器(GB/T 14579—2013/IEC 60384-17:2005);
  - 第 17-1 部分:空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平 E 和 EZ(GB/T 14580—2013/IEC 60384-17-1:2005);
  - 第 18 部分:分规范 固体(MnO<sub>2</sub>)和非固体电解质片式铝固定电容器(GB/T 17206—1998/IEC 60384-18:1993,第 1 号修改单:1998);
  - 第 18-1 部分:空白详细规范 表面安装固体(MnO<sub>2</sub>)电解质铝固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 17207—2012/IEC 60384-18-1:2007);
  - 第 18-2 部分:空白详细规范 非固体电解质片式铝电解质固定电容器 评定水平 E(GB/T 17208—1998/IEC 60384-18-2:1993);
  - 第 19 部分:分规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容器(GB/T 15448—2013/IEC 60384-19:2005);
  - 第 19-1 部分:空白详细规范 表面安装金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流固定电容 评定水平 EZ(GB/T 16467—2013/IEC 60384-19-1:2006);
  - 第 21 部分:分规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21041—2007/IEC 60384-21:2004);
  - 第 21-1 部分:空白详细规范 表面安装用 1 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 21038—2007/IEC 60384-21-1:2004);
  - 第 22 部分:分规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器(GB/T 21042—2007/IEC 60384-22:2004);
  - 第 22-1 部分:空白详细规范 表面安装用 2 类多层瓷介固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 21040—2007/IEC 60384-22-1:2004);
  - 第 25 部分:分规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器(GB/T 6346.25—2018/IEC 60384-25:2015);
  - 第 25-1 部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ(GB/T 6346.2501—2018/IEC 60384-25-1:2004)。

本部分为《电子设备用固定电容器》的第 25-1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用 IEC 60384-25-1:2006《电子设备用固定电容器 第 25-1 部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会(SAC/TC 165)归口。

本部分起草单位:福建国光电子科技股份有限公司。

本部分主要起草人:黄惠东、张易宁、徐加胜、葛宝全、程蓓斯、陈巧琳、王国平。

## 电子设备用固定电容器 第 25-1 部分： 空白详细规范 表面安装导电高分子 固体电解质铝固定电容器 评定水平 EZ

### 引言

#### 空白详细规范

空白详细规范是分规范的一种补充性文件,它包括了详细规范的格式、编排和最少内容的要求。不遵守这些要求的详细规范不认为是符合 IEC 要求的规范,也不能称作 IEC 标准。

在制定详细规范时应考虑分规范 1.4 的内容。

详细规范的首页上各括号中的数字表示在此位置上应填写下列内容。

#### 详细规范的识别

- [1] 授权起草本详细规范的组织:IEC 或国家标准化机构。
- [2] IEC 或国家标准的详细规范编号、出版日期以及国家体制所需要的其他内容。
- [3] IEC 或国家标准的总规范编号及其版本号。
- [4] IEC 或国家标准的空白详细规范编号。

#### 电容器的识别

- [5] 电容器的简短说明。
- [6] 典型结构的信息(适用时)。
- [7] 标有对互换性有重要影响的主要尺寸的外形图和(或)引用国家或国际的关于外形方面的文件。另一种方法可在详细规范的附录中给出这种图形。
- [8] 应用或应用组别和(或)评定水平。
- [9] 最重要特性的参考数据,以便在各种不同类型的电容器之间能进行比较。

[1]	[2]
[3]	[4]
评定质量的电子元器件:	GB/T 6346.2501—2018/IEC 60384-25-1:2006
[7]	[5]
	表面安装导电高分子电解质固定铝电解电容器
	[6]
外形图:(见表 1) (_角视图)	[8]
	评定水平: EZ